

中信证券股份有限公司

关于杰华特微电子股份有限公司

2022 年度持续督导跟踪报告

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为杰华特微电子股份有限公司（以下简称“杰华特”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，负责杰华特上市后的持续督导工作，并出具本持续督导年度跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	保荐机构已与杰华特签订《保荐协议》，已明确双方在持续督导期间的权利和义务，并已报上海证券交易所备案
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐机构通过日常沟通、定期及不定期回访等方式了解业务经营情况，对杰华特开展持续督导工作
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	在本持续督导跟踪报告期间杰华特未发生按相关规定须保荐机构公开发表声明的违法违规情况
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等	在本持续督导期间内杰华特未发生违法违规或违背承诺等事项
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺	在本持续督导期间，保荐机构督导杰华特及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所

序号	工作内容	持续督导情况
		交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	保荐机构督促杰华特进一步完善公司的治理制度并严格执行
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序和规则等	保荐机构督促杰华特进一步完善公司的内控制度并规范运行
9	督促上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分的理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	保荐机构督促杰华特进一步完善信息披露制度并严格执行，审阅其信息披露文件
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	保荐机构对杰华特的信息披露文件进行事前或事后的及时审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完成内部控制制度，采取措施予以纠正	在本持续督导期间，杰华特及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在上述事项的情况
12	持续关注上述公司及其控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告	在本持续督导期间，杰华特及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况
13	关注公共传媒关于上市公司的报告，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告	在本持续督导期间，经保荐机构核查，杰华特不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
14	发行以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违法《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情	在本持续督导期间，杰华特未发生前述情况

序号	工作内容	持续督导情况
	形；（三）公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查质量	保荐机构已制定现场检查的相关工作计划，并明确了具体的检查工作要求
16	上述公司出现以下情形之一的，保荐人应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；（二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集资金；（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上；（七）上海证券交易所要求的其他情形	在本持续督导期间，杰华特不存在前述情形

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

在本持续督导期间，保荐机构和保荐代表人未发现杰华特存在重大问题。

三、重大风险事项

在本持续督导期间，公司主要的风险事项如下：

（一）核心竞争力风险

1. 产品研发未达预期的风险

公司作为综合性的模拟集成电路供应商，致力于为市场提供一站式的模拟集成电路解决方案。为保持技术先进性，提高公司核心竞争力，公司需要基于技术发展趋势和终端客户需求，不断进行技术升级与创新，持续迭代现有产品并推出新产品。因此，公司产品研发执行“多产品线同时并行”的方案。未来，若公司在研发过程中的关键技术未能突破、相关性能指标未达预期，或是公司研发进度较慢，相关产品推出市场后未获认可，公司将面临研发投入难以收回、市场开拓出现滞缓等风险，对公司未来发展产生不利影响。

2. 关键技术人员流失的风险

集成电路设计行业是智力密集型行业，人力资源是集成电路设计企业的发展基础，亦是公司保持持久竞争优势的关键因素之一。公司已构建了一支专业的人才技术团队，研发技术人员占比达到六成以上。未来，若公司内部组织建设情况不佳，内部薪酬考核机制在同行业中丧失竞争力，或员工晋升机制未能得到高效率执行，公司可能面临关键技术人员流失且无法引入更多高水平技术的风险，进而对公司未来发展产生不利影响。

3. 公司核心技术泄密的风险

公司核心技术涵盖工艺平台改进、电路和版图设计以及质量管理等芯片生产的各个环节，是公司保持竞争力、持续发展的重要基础。若公司因内部管理不善、工作疏忽、外部窃取等因素，导致相关技术外泄，将可能削弱公司的核心竞争力，对公司未来的市场开拓与业务增长产生不利影响。

4. 虚拟 IDM 模式的研发风险

公司采取虚拟 IDM 模式，不仅专注于集成电路设计环节，亦拥有自己专有的工艺技术，能要求晶圆厂商配合导入自有的制造工艺，并用于自身产品当中。公司采取虚拟 IDM 模式，有助于提升产品性能、加快产品迭代并增强与晶圆厂的合作关系，但同时也使得公司研发投入增加，并对公司内部的工艺研发能力和研发体系提出了较高要求。如公司在工艺持续研发和迭代过程中未能如期完成或研发失败，可能无法及时有效地进行产品迭代并造成研发损失，进而对公司未来发展产生不利影响。

(二) 经营风险

1. 客户和供应商集中度风险

报告期内，公司客户集中度有明显上升，其中第一大客户收入占比 41.59%，随着双方业务合作关系的不断深入，公司与第一大客户的收入及毛利占比可能进一步提高。未来，若公司主要客户的经营发展战略、采购战略等发生较大变化，或公司因自身发展原因与主要客户间的合作空间减少，亦或公司主要客户的经营情况或资信情况发生较为不利的变化，将直接对公司的经营业务产生不利影响。

报告期内，公司对前五大供应商采购金额合计占采购总额的比例为 74.83%，

采购的集中度相对较高。公司采取虚拟 IDM 模式，晶圆制造、封装测试等制造环节均由外部供应商完成。未来，若供应商自身业务经营情况发生不利变化，自身资质与技术水平无法满足公司对工艺器件的要求，亦或因产能受限无法及时供货等，将直接影响到公司的具体业务开展。

2. 上游产能波动的风险

近年来，中国半导体产业发展迅速，下游客户的应用市场需求多样化，尽管公司基于国内晶圆、封测厂的资源，已构建了完善的供应链体系。未来，若市场行情出现较大波动，抑或行业竞争加剧，公司仍旧可能面临产能供应不足的风险，并直接影响到公司具体业务的开展。

3. 规模扩张导致的管理风险

报告期内，公司业务规模有所增长，相应资产规模和人员也在不断扩张。随着公司股票的公开发行业以及募集资金投资项目的实施，公司业务规模以及人员团队预计将进一步扩大，这将对公司在资源整合、技术开发、市场开拓、质量管控等多方面提出更高的要求。若公司内部管理水平无法很好地适应公司快速发展要求，将使公司可能发生因为规模扩张导致的管理风险，对公司进一步发展产生不利影响。

（三）财务风险

1. 公司收入增长持续性风险

报告期内，公司实现营业收入 144,767.82 万元，呈高速增长趋势。其中第一大客户在 2022 年收入占比 41.59%，系公司营业收入快速增长的重要原因。未来，若公司主要客户的经营情况、资信情况或其产品未来市场空间发生较为不利的变化，导致主要客户的采购需求大幅下降，或公司在技术、产品等方面丧失竞争优势，或公司在原材料采购及封装测试环节上产能不足，公司将面临业绩无法保持高速持续增长的风险。

2. 公司产品毛利率波动风险

近两年，公司主营业务毛利率分别为 42.16%和 39.93%，存在毛利率波动的

情况。公司产品毛利率水平主要受产品结构、市场供求关系、技术先进性、产品更新迭代、市场销售策略等因素综合影响。由于公司产品类别较多，产品型号丰富，各类产品面对的市场竞争、产品周期和迭代进度均有差异。若未来主要应用领域的客户对芯片的市场需求大幅下降，或公司未能根据客户需求变化及时研发或迭代产品导致产品不具有竞争优势，或公司在产品销售过程中未达预期造成高毛利产品销售占比下降，可能导致公司毛利率水平出现波动，进而对公司经营业绩产生不利影响。

3. 存货规模较大及跌价风险

报告期末，公司存货账面余额为 81,854.60 万元，存货余额有所增幅；公司存货跌价准备为 3,569.38 万元，占存货账面余额的比例为 4.36%，存货跌价准备计提比例较高。若未来市场环境发生变化、竞争格局变化、客户需求下降或产品迭代导致存货产品滞销、存货积压，可能导致公司存货跌价风险增加，进而对公司的盈利能力产生不利影响。

4. 公司产能保证金回收风险

报告期末，公司尚未收回的产能保证金账面余额为 51,226.89 万元。公司目前产能保证金支付金额较大，若公司未来采购量未达到计划采购量，或相关供应商生产经营情况发生不利变化导致无法偿还保证金，可能导致公司产能保证金无法收回的风险。

5. 净资产收益率下降的风险

募集资金到位后，公司的净资产规模有所增长，但募集资金投资项目需要一定的建设期，项目全面达产也需要一定的时间，因此，公司存在短期内净资产收益率下降的风险。

6. 税收优惠政策调整的风险

公司享受的税收优惠税种主要为企业所得税。根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室文件《关于对浙江省 2021 年认定的第一批高新技术企业进行备案的公告》，公司被认定为高新技术企业，认定有效期 3 年（2021 年至 2023 年）。目前公司按 15% 的税率计缴企业所得税。如果未来国家主管部门对相关税

收优惠政策、政府补助政策作出调整或其他原因导致公司不再符合相关的认定或鼓励条件，导致公司无法享受上述税收优惠政策及政府补助，则可能对公司经营业绩和盈利能力产生不利影响。

（四）行业风险

1. 半导体行业政策调整风险

公司所处的集成电路行业是国家重点鼓励发展的领域之一。国务院、各主管部门为行业发展营造了良好的政策环境，行业主要法律法规和政策鼓励充分的市场竞争，保护企业的合法合规经营，并规划了长远的发展路径，为国内集成电路行业的发展带来了良好的发展机遇。未来，若国家对集成电路相关产业政策的支持力度减弱，将对公司未来发展产生一定不利影响。

2. 半导体市场竞争加剧风险

随着应用场景不断丰富，技术不断升级，模拟芯片市场正进入高速发展阶段。模拟集成电路良好的发展前景，吸引了诸多国内企业进入该领域；业内企业则在持续进行技术创新与产品开拓，进一步增强市场竞争力。公司深耕模拟集成电路领域多年，通过自研工艺的迭代与多品类大量产品的设计实践，已积累了丰富的产品开发经验，部分主要产品的关键性能指标已处于国际领先或国内先进水平。但相对国际龙头模拟电路厂商，公司在产品数量、市场竞争力上还存在一定差距。未来，若公司无法持续推出具有核心竞争力的产品，在国际竞争中形成竞争优势，将对公司未来的市场份额、经营业绩等产生不利影响。

（五）宏观环境风险

2022 年来，随着国际贸易摩擦的加剧，国内企业的芯片采购以及对外销售均受到了一定程度的影响。目前，公司已构建了面向国内的完善的供应链体系，且形成了以境内为主的销售体系。但若国际贸易摩擦持续发酵，相关国际环境持续恶化，或国外出台限制我国集成电路行业发展的相关政策，公司可能发生供应链受到一定限制、无法持续获得产能供应或者对外销售市场受到限制等情况，对公司日常经营活动的开展产生不利影响。

（六）募投项目实施效果未及预期的风险

募集资金投资项目的项目管理和组织实施是项目成功与否的关键因素。若投资项目不能按期完成，或未来市场发生不可预料的不利变化，公司的盈利状况和发展前景将受到不利影响。

虽然公司对募集资金投资项目进行了充分的可行性论证，但由于募投项目经济效益分析数据均为预测性信息，项目建设尚需较长时间，届时如果产品价格、市场环境、客户需求出现较大变化，募投项目经济效益的实现将存在较大不确定性。如果募投项目无法实现预期收益，募投项目相关折旧、摊销、费用支出的增加则可能导致公司利润出现下降的情况。

四、重大违规事项

在本持续督导期间，不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	1,447,678,221.95	1,041,559,526.58	38.99
归属于上市公司股东的净利润	137,160,035.60	141,975,034.24	-3.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95,903,695.49	136,131,746.09	-29.55
经营活动产生的现金流量净额	-823,487,045.35	-321,351,203.89	不适用
主要会计数据	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	3,142,345,555.87	937,158,562.49	235.31
总资产	4,360,494,130.01	1,171,777,065.30	272.13

（二）主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减 (%)
基本每股收益（元/股）	0.35	0.39	-10.26
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.39	-10.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.25	0.37	-32.43

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减 (%)
益(元/股)			
加权平均净资产收益率(%)	13.55	23.51	减少9.96个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.47	22.54	减少13.07个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	21.05	19.07	增加1.98个百分点

(三) 主要会计数据和财务指标的说明

1、2022 年公司营业收入增长 38.99%，主要系报告期内公司持续推出新产品，引入更多优质客户以及深化与现有客户的合作所致。

2、2022 年度公司经营活动产生的现金流量净额较上年下降，主要系：①公司为锁定供应商的产能向其支付产能保证金；②2022 年公司业务规模持续增长，相应存货和应收账款增加，以及人员不断增加，使得经营性支出增加。

3、2022 年公司归属于上市公司股东的净资产、总资产，较上年分别增长 235.31%、272.13%。主要系 2022 年公司在科创板首次公开发行股票，股本和资本公积增加，以及利润增加所致。

4、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降 32.43%、加权平均净资产收益率同比减少 9.96 个百分点、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率同比减少 13.07 个百分点，主要系 2021 年三季度公司引进投资，股本和资本公积增加，使得 2022 年期初净资产增长，使得加权平均净资产增长，以及报告期内公司完成首次公开发行股票所致。

六、核心竞争力的变化情况

(一) 工艺-设计-系统的技术体系优势

公司自成立以来，始终坚持发展独立自主的芯片研发技术，目前已形成了从工艺、设计再到系统的完整研发技术体系架构。首先，集成电路设计企业的产品制造工艺往往由各大晶圆厂提供，出于成本控制与规模化生产角度考虑，各大晶圆厂往往仅能提供标准化的芯片制造工艺平台，无法针对特定型号芯片进行专门化的工艺调整，故无法保障芯片实现最佳性能。同时，受限于国内晶圆代工厂的模拟芯片相关工艺跟国际先进水平的差距，大部分设计公司不得不选择国外的晶

圆代工厂，无法真正做到供应链的自主可控。公司旨在突破行业固有工艺水平限制，利用国内晶圆厂现有资源，组建工艺研发团队，根据产品需求针对性研发特定工艺，使工艺制造水平与芯片开发需求相匹配，以实现芯片最优性价比。公司已在国内主要晶圆厂构建了 0.18 微米的 7 至 55V 中低压 BCD 工艺、0.18 微米的 10 至 200V 高压 BCD 工艺、以及 0.35 微米的 10 至 700V 超高压 BCD 工艺等三大类工艺平台，各工艺条线均已迭代一至三代，初步形成了系统的自研工艺体系。同时，在与晶圆厂合作过程中，公司既帮助晶圆厂调试提升了 BCD 工艺水平，又实现了企业自身上游供应链的完全国产化，客观上实现了双赢效果。

其次，公司具有较强的芯片设计能力，公司核心研发团队深耕模拟芯片领域多年，对集成电路布图设计具有深刻理解与丰富经验，产品设计能力可覆盖各主要类别的电源管理芯片产品，并逐步覆盖各类信号链产品。因此，区别于一般模拟芯片设计公司仅重点提供单一类别芯片产品，公司致力于发展多品类的系列芯片，构建起了较为完善的多品类模拟芯片产品自主研发体系。

其三，基于自身工艺与电路设计优势，公司可根据芯片产品的下游具体应用场景进行系统优化，通过调整芯片的应用架构、关键参数等，实现公司芯片产品与应用系统的最优搭配，进一步降低成本、提升效率。

（二）宽领域的产品布局优势

公司现已覆盖了大部分业界主流电源管理芯片品类，并逐步覆盖多品类信号链产品，在各大产品线形成了具有首创性的系列产品，研发出了诸如高频 SR 系列同步整流产品、面向通讯和服务器电源市场的 100V 半桥大电流驱动产品以及支持 PoE++ 协议的 PSE 芯片等。截至报告期末，公司拥有 1,000 款以上可供销售的产品型号，已成为综合性的模拟芯片供应商。

凭借不断的工艺迭代与研发创新，公司部分主要产品已处于国际先进、国内领先水平，在多领域具备较强竞争力。如公司研发的智能功率级模块芯片，具有极高功率密度，具备电流和温度精确侦测功能，得到了市场的认可。公司通过不断技术创新，全方位参与模拟芯片的市场竞争，不断提升产品的市场占有率。公司将继续深入从低功率到高功率全系列产品布局，为各行业客户提供一站式采购服务选择。

（三）专业的人才团队优势

集成电路设计行业是智力密集型行业，人力资源是集成电路设计企业的发展基础，是缩小国内外集成电路设计行业发展差距的关键要素。公司高度重视人才队伍建设，通过内部积极培养以及外部引进人才等多种方式，已形成了一支具有竞争力的高素质人才队伍。

此外，公司核心研发团队拥有国内外知名大学教育背景，并具有在国际领先模拟集成电路厂商长期一线工作的经验，专注从事电源管理芯片、信号链芯片等主流模拟集成电路领域的深入研究，对于工艺研发与芯片设计皆有深刻的理解和丰富的经验。除公司研发团队外，公司销售、运营、质量管控等核心团队均拥有半导体相关行业教育背景与长期从业经验。

（四）完备的质量管控优势

产品性能与可靠性是衡量芯片水平的重要指标。公司高度重视产品质量控制，组建了一支从设计、生产、测试再到运营管控全流程管理的后端团队，深入了解芯片物理层面的运行逻辑，具备从微观视角针对性解决根本问题的能力，以高于行业标准的产品质量规范对生产全流程进行管控，进而向市场供应高质量产品与服务。

公司质量控制团队在创立之初，主要通过在国内头部企业招募后端管理人员搭建了基本框架，后为满足各行业头部客户对产品质量的高要求，公司不断改进质量管控方式，目前已形成了一支经验丰富的质量控制管理团队，建立了严格高效的质量管控架构。

目前，公司产品已通过 ISO9001：2015 认证以及 ISO14001：2015 等认证。基于卓越的质量保障措施，公司产品在不同应用环境下均保持着较高的稳定性，上线失效率水平远低于客户要求。产品的高性能与高质量，为公司扩大客户范围、树立品牌形象提供了坚实基础。

（五）完善的供应链体系

在国家政策支持下，我国电源管理集成电路行业呈现出快速发展的趋势，但总体水准与国际先进水平尚存在一定差距，对国外芯片存在一定依赖。同时受到

国际局势影响，未来境内外芯片业务合作交流存在不稳定性。因此，摆脱境外芯片依赖，建立稳定、高质量的国内芯片供应链体系，已是国内芯片设计企业所面临的关键难题。公司基于自身从工艺到系统的研发技术体系优势，与国内主要晶圆厂及封测厂开展了广泛业务合作与工艺技术交流，量产的多款产品均为国际先进、国内领先。公司在保证产品竞争力的同时，进一步优化了以境内为主的上游供应商体系，强化了公司稳定的国内供应链渠道优势。

（六）丰富的客户资源优势

公司凭借自身的技术闭环优势，以及优秀的客户服务能力，目前已与多个模拟芯片下游应用市场的龙头企业建立了长期合作关系。目前，公司已成为国内主要通讯客户和安防客户的供应商，并进入了汽车电子、通讯电子、计算和存储、工业应用、消费电子等众多领域头部客户的供应链体系。

公司在与下游客户合作过程中，形成了相互促进的良性互动机制。一方面，公司进入下游客户的供应体系后，通过频繁深入的技术交流，不断提高自身的研发技术水平，使产品的应用深度与广度得以拓展，产品前瞻性和品质得以快速提升，进一步加快了业务的发展。另一方面，在成功进入大客户的供应商体系后，公司依靠大客户对产品认可度的背书，使自身产品具有更广阔的市场空间，进一步加快了市场销售规模的扩大。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出变化情况

公司 2022 年度研发投入总额为 304,724,274.75 元，2021 年度研发投入总额为 198,575,626.70 元，2022 年度较上年度增长 53.46%，主要系 2022 年公司研发人员数量增长，相应薪酬费用增加，以及研发材料和试制费等投入增加所致。截至 2022 年 12 月 31 日，研发人员为 407 人，较上年度 281 人增长 44.84%，上述人员的增加导致研发整体薪酬增加。

（二）研发进展情况

2022 年度，公司研发项目进展顺利，并取得相应的研发成果。

截止报告期末，核心技术已申请国内外专利 985 项，实用新型专利 313 项。已获得有效国内外专利 447 项，实用新型专利 262 项，集成电路布局设计登记证书 50 项。报告期内，公司新增已授权知识产权 73 项，其中发明专利 58 项，实用新型专利 9 项，软件著作权 5 项，集成电路布局设计登记证书 1 项。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

（一）募集资金的使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司的募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

项 目		金 额
募集资金净额		205,468.49
截至期初累计发生额	项目投入	-
	利息收入净额	-
本期发生额	项目投入	5,989.14
	利息收入净额	-0.03
截至期末累计发生额	项目投入	5,989.14
	利息收入净额	-0.03
应结余募集资金		199,479.32
实际结余募集资金		202,043.02
差异		-2,563.70

注：差异 2,563.70 万元系公司尚未支付的发行费用。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

币种：人民币 单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
浙商银行股份有限公司杭州余杭支行	3310010240120100189457	240,108,627.44	

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国农业银行股份有限公司 杭州余杭支行	19053401040003390	465,342,722.27	
中信银行股份有限公司杭州 分行	8110801013302568559	210,644,250.00	
交通银行股份有限公司杭州 萧山支行	3050692500130001562 63	483,737,657.18	超募账户
南京银行股份有限公司杭州 分行	0701260000003518	309,548,725.00	
中国工商银行股份有限公司 杭州余杭支行	1202220919900321518	311,048,177.50	
合 计		2,020,430,159.39	

(二) 募集资金的使用是否合规

2022 年度，募集资金存放和使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2022 年 12 月 31 日，控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的杰华特股份未发生变动，不存在质押、冻结及减持的情形。

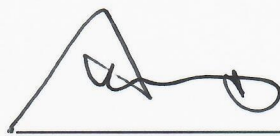
十一、本所或者保荐机构认为应当发表意见的其他事项

截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

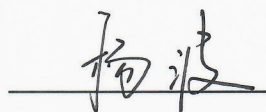
(以下无正文)

(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于杰华特微电子股份有限公司 2022 年度持续督导跟踪报告》之签署盖章页)

保荐代表人:

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'J' followed by a horizontal line and a loop.

金 田

A handwritten signature in black ink, consisting of the characters '杨波' written in a cursive style.

杨 波

(本页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于杰华特微电子股份有限公司 2022 年度持续督导跟踪报告》之签署盖章页)

